



# 电子化工新材料产业联盟

## 简 报

2023 年第 7 期

电子化工新材料产业联盟秘书处编印

地址：北京市朝阳区胜古中路 2 号院金基业大厦 716 室电话：010-64476901/64498802

邮箱：cem@cemia.org.cn

传真：010-64455623

联盟网站：www.ecmr.org.cn

微信公众号：电子化工新材料产业联盟

### 目 录

#### 【行业要闻】

2023 年第五批国家专精特新“小巨人”企业名单日前公布，电子化学品领域多家企业上榜

中芯国际再度“换帅”，高永岗辞任董事长、刘训峰接任

华虹半导体拟筹资 212 亿元科创板上市

群创：公司在印度的合作计划没变、持续进行

威顿晶磷完成亿元级 Pre-IPO 轮融资 专注于泛半导体材料研发

诚志股份：拟不进行液晶单体材料及中间体材料产能扩充项目

#### 【统计数据】

海关总署：2023 年前 6 个月中国大陆 IC 进口同比下降 18.5%

2023 年上半年电子信息制造业运行情况

#### 【财报速递】

台积电 6 月营收 1564 亿元新台币 年减 11%

面板厂上半年业绩预告出炉

#### 【产业分析】

半导体：印度能否成为全球芯片强国？

【行业要闻】

2023 年第五批国家专精特新“小巨人”企业名单日前公布，电子  
化学品领域多家企业上榜

2023 年第五批国家专精特新“小巨人”企业名单日前公布，全国总计 3671 家企业入选，电子化学品领域多家企业上榜。

序号	地区	企业名称
1	江苏省	江苏博砚电子科技股份有限公司
2	江苏省	苏州博洋化学股份有限公司
3	江苏省	南通新宙邦电子材料有限公司
4	江苏省	镇江润晶高纯化工科技股份有限公司
5	天津市	绿菱电子材料（天津）有限公司
6	福建省	博纯材料股份有限公司
7	上海市	上海正帆科技股份有限公司
8	山东省	山东合益气体股份有限公司
9	湖南省	湖南松井新材料股份有限公司
10	湖南省	湖南利德电子浆料股份有限公司
11	河北省	河北海力恒远新材料股份有限公司
12	广东省	广东华特气体股份有限公司

13	广东省	惠州市宙邦化工有限公司
14	浙江省	衢州杭氧特种气体有限公司
15	浙江省	浙江奥首材料科技有限公司
16	安徽省	合肥正帆电子材料有限公司
17	湖北省	易安爱富（武汉）科技有限公司
18	湖北省	湖北和远气体股份有限公司
19	湖北省	湖北兴福电子材料股份有限公司

专精特新“小巨人”企业是国家专为优质企业设立的荣誉奖项，认定标准围绕“专、精、特、新、链、品”六个方面，分别提出定量和定性指标，被认定企业需满足专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品所属领域这六项指标要求；是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的“排头兵”企业，以“补短板”“锻长板”“填空白”、解决“卡脖子”问题为主。

### 中芯国际再度“换帅”，高永岗辞任董事长、刘训峰接任

千亿晶圆代工龙头中芯国际（688981.SH）迎来重大人事变动。

7月17日晚间，中芯国际公告称，董事长高永岗因工作调整，辞任本公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务，自2023年7月17日起生效。本次接替高永岗的是公司副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员刘训峰博士。

公告显示，刘训峰博士，现年58岁，历任中国石化上海石油化工股份有限公司乙烯厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理及副总经理，上海赛科石油化工有限责任公司副总经理，上海化学工业区发展有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司党委副书记、总裁、党委书记、董事长，上海华谊集团股份有

限公司党委书记及董事长，上海华谊控股集团有限公司董事长，中芯国际副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员。

## 华虹半导体拟筹资 212 亿元科创板上市

华虹半导体 7 月 23 日发布晚间公告称，公司将在 7 月 25 日启动申购，发行价 52 元，公开发行人股票数量约为 4.08 亿股（A 股），预计募集资金总额为 212.03 亿元。募集资金主要拟投入于华虹制造（无锡）项目、8 英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目等。

其中，华虹制造（无锡）项目预计总投资额为 67 亿美元，将建设一条工艺等级覆盖 65/55-40nm，月产能 8.3 万片的 12 英寸特色工艺生产线。项目聚焦车规级芯片，对非易失性存储器、电源管理、功率器件等工艺领域进行深入布局 and 研发，持续提升在新能源汽车、物联网、新能源、智能终端等领域的应用。该项目的落地将显著提升公司产能，并助力公司的特色工艺技术迈上新台阶。

值得一提的是，若华虹半导体此次募资顺利完成，将成为今年以来 A 股募资金额最高 IPO。

## 群创：公司在印度的合作计划没变、持续进行

对于鸿海与印度 Vedanta 合作兴建半导体的关系将终止是否影响到面板大厂群创光电在印度的面板厂合作案，群创指出，目前公司在印度的合作计划没有改变，仍在持续进行中。

群创系于今年第一季与印度 Vedanta 集团签订 TFT-LCD 技转合约，将协助策略伙伴在印度建立 8 代 a-Si TFT-LCD 液晶面板前后段产线。预计后段模组产线将在 2024 年下半年量产，前段产线将于 2026 年投产。

## 威顿晶磷完成亿元级 Pre-IPO 轮融资 专注于泛半导体材料研发

据“治臻咨询”公众号报道，近日，国内领先的超高纯电子化学品提供商威顿晶磷宣布完成亿元级 Pre-IPO 轮融资，本轮投资由厦门联和资本领投，元禾璞华、北京电控创投、联新资本、中金资本旗下基金等机构亦参与投资，Zen Advisory 担任独家财务顾问。本轮融资的完成将帮助威顿晶磷拓展新的产品线以及产能的扩充。

据公开资料显示，威顿晶磷主要从事泛半导体材料的研发、生产及销售，主要产品包括集成电路先进制程晶圆制造和光伏电池片制造中所用到的各类前驱体、掺杂剂、以及其他超高纯电子化学品，客户覆盖大部分光伏电池片厂商以及主流集成电路晶圆代工厂。

### 诚志股份：拟不进行液晶单体材料及中间体材料产能扩充项目

财联社7月4日电，诚志股份公告，因公共卫生事件的影响，沧州建设液晶单体材料项目和中间体材料项目推进速度放缓，在此期间，市场环境发生变化，液晶面板出货量下降，竞争加剧，致使液晶价格下滑趋势显著。为了应对上述不利变化，经公司综合研判，决定暂不进行液晶单体材料及中间体材料的产能扩充。拟将控股子公司沧州诚志永华“78吨/年液晶单体材料项目和243吨/年中间体材料项目”计划占地146183.20平方米（219.28亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。

### 【统计数据】

#### 海关总署：2023年前6个月中国大陆IC进口同比下降18.5%

海关总署官网7月13日公布的数据显示，2023年前6个月中国大陆集成电路（IC）进口量同比下降18.5%。2023年前六个月，中国大陆集成电路进口量降至2277亿个，而去年同期为2796亿个。相比起2023年前5个月19.6%的降幅略有收窄。

2023年上半年，中国大陆芯片进口总额下降22.4%，至1626亿美元，降幅远大于中国大陆整体进口的降幅，后者同比下降0.1%。

### 2023年上半年电子信息制造业运行情况

7月31日消息，工信部发布2023年上半年电子信息制造业运行情况，上半年，规模以上电子信息制造业增加值与去年同期持平，增速较1—5月份提高0.3个百分点，实现由负转正；增速分别比同期工业、高技术制造业低3.8个和1.7个百分点。6月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长1.2%。上半年，主要产品中，手机产量6.86亿台，同比下降3.1%，其中智能手机产量5.07亿台，

同比下降 9.1%；微型计算机设备产量 1.62 亿台，同比下降 25%；集成电路产量 1657 亿块，同比下降 3%。

## 【财报速递】

### 台积电 6 月营收 1564 亿元新台币 年减 11%

台积电 7 月 10 日公布 2023 年 6 月净营收，合并计算 6 月营收约为 1564 亿元新台币（单位下同），较 5 月减少 11.4%，同比较 2022 年 6 月减少 11.1%，第二季营收 4808.41 亿元，季减 5.46%，符合财测预期。

2023 年 1 月至 6 月营收总计 9,894.7 亿元，较 2022 年同期减少 3.5%。

**面板厂上半年业绩预告出炉：京东方、华映科技、深天马、维信诺、群创、三星.....**

7 月 14 日，部分面板厂上半年业绩预告相继出炉，从预告来看，因全球经济低迷、面板行情较差，上半年面板厂总体的业绩还是差强人意，不过随着市场的回暖，有的面板厂 Q1 业绩欠佳，但 Q2 已开始反弹。从面板厂的预期来看，下半年业绩还是值得期待的。

### BOE（京东方）2023 年半年度业绩预告 单季环比增长

7 月 14 日，京东方科技集团股份有限公司（京东方 A：000725；京东方 B：200725）发布 2023 年半年度业绩预告，2023 年上半年预计实现归属于上市公司股东净利润 7 亿元-8 亿元，预计实现基本每股收益 0.016 元/股 - 0.019 元/股。

## 一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023年1月1日—2023年6月30日

2、预计的业绩：同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：70,000万元 - 80,000万元	盈利：659,566万元
	比上年同期下降：88% - 89%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：150,000万元 - 160,000万元	盈利：423,946万元
	比上年同期下降：135% - 138%	
基本每股收益	盈利：0.016元/股 - 0.019元/股	盈利：0.17元/股

注：基本每股收益上年同期以2022年6月30日扣除公司回购专用证券账户中的股份和尚未解锁的限制性股票股份后的总股本37,574,145,041股加权计算，本报告期以2023年6月30日扣除公司回购专用证券账户中的股份和尚未解锁的限制性股票股份后的总股本37,457,807,349股加权计算。

BOE（京东方）表示，在全球宏观经济、市场需求不断变化的背景下，公司仍保持稳健经营，自2023年起盈利逐季改善，其中第二季度预计收入环比增长，扣除非经常性损益后的净利润预计实现盈利，为全年整体业绩向好打下坚实基础。

### 明显减亏！彩虹股份2023年上半年预亏2.5亿-2.9亿

7月13日，彩虹股份（600707）发布2023年半年度业绩预告，预计2023年半年度实现归属于母公司股东的净利润为-2.5亿元到-2.9亿元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3亿元到-3.4亿元。

上年同期归属于母公司股东的净利润：-114,404.28万元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-171,243.80万元。

### 华映科技预计，上半年净亏损7.06亿元至7.46亿元

7月14日晚，华映科技(000536.SZ)发布2023年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东净亏损7.06亿元至7.46亿元，预计扣除非经常性损益后亏损7.1亿元至7.5亿元。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日

2、业绩预告情况：预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：70,600 万元 - 74,600 万元	亏损：36,572.13 万元
	比上年同期下降：93.04% - 103.98%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：71,000 万元 - 75,000 万元	亏损：37,521.23 万元
	比上年同期下降：89.23% - 99.89%	
基本每股收益	亏损：0.2552 元/股 - 0.2697 元/股	亏损：0.1322 元/股

**深天马 A：预计 2023 年上半年营收持稳 oled 出货量大幅提升**

7 月 14 日晚，深天马 A（000050）发布半年度业绩预告，需求和价格双重压力下，营收持稳，预计 2023 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为-14.60 亿元--14.00 亿元。

**维信诺预计二季度营收翻倍 环比增长 115%到 154%**

7 月 14 日晚，维信诺发布 2023 半年度业绩预告，预计上半年实现营收区间为 24.25 亿元至 27.25 亿元，同比减少 20%到 29%，其中，第二季度预计实现营收为 16.56 亿元至 19.56 亿元，较第一季度增长 115%到 154%。预计上半年净亏损 15.8 亿元-17.8 亿元。

**友达、群创 Q2 营收均环比增 2 成**

群创 6 月营收 193.49 亿元（新台币，下同），月增 3.43%、年增 0.32%，连续两月缴出年月双增成绩，第二季营收达 550.87 亿元，季增 20.82%、年减也大幅降至 4.86%；出货表现来看，6 月大尺寸面板出货量共计 1,240 万片，较上月增加 10.6%，中小尺寸面板出货量共计 2,411 万片，月减 13.8%。

友达 6 月合并营收为 229.5 亿元，较上月增加 5.3%，与去年同期相比增加 10.9%。累计 2023 年第二季合并营业额为 633.1 亿元，较第一季增加 23.7%，与去年同期相比增加 0.7%。6 月份面板总出货面积达 201.7 万平方米，较 5 月份微幅下降 1.5%。2023 年第二季面板总出货面积达 570.6 万平方米，较第一季增加



32.7%，与去年同期相比增加 16.0%。

### 彩晶、凌巨 6 月营收增

中小尺寸面板厂彩晶（6116）及凌巨（8105）7 月 10 日同步公告今年 6 月合并营收，彩晶 12.21 亿元（新台币，下同），月增 21.5%，年减 18.9%，为近 7 个月单月新高。凌巨 8.03 亿元，月增 2.5%，年减 15.7%，是近 5 个月新高。

彩晶 6 月中小尺寸面板出货量共计 3,346 万片，月增 43.9%；大尺寸及自有品牌产品出货量共计 11.4 万片，月增 25.2%。

彩晶第 2 季合并营收 34.16 亿元，季增 27.7%，年减 24%。累计今年上半年合并营收 60.92 亿元，年减 35.5%。今天股价维持平盘，成交量 7,912 张，收 13.05 元。

凌巨今年第 2 季合并营收 23.5 亿元，季微减 0.1%，年减 9.8%。累计上半年合并营收 47.01 亿元，年减 9.5%。今天股价小涨 0.3 元，成交量 3,339 张，收 15.8 元。

## 【产业分析】

### 半导体：印度能否成为全球芯片强国？

自印度宣布激励本土半导体制造业并启动国家任务以来已经一年半了，但进展却很缓慢。

就在美国科技巨头美光公司宣布将投资近 30 亿美元（23 亿英镑）在西部古吉拉特邦建设一座组装和测试工厂几天后，台湾科技巨头富士康退出了与印度 Vedanta 的 195 亿美元合资企业，以在该国建设一家芯片制造工厂。

当地媒体称，至少另外两家公司的计划似乎已陷入停滞。

但在莫迪政府等待芯片制造商提供高价值投资以匹配 100 亿美元激励支出的同时，它一直在签署一系列技术合作伙伴关系，以使该行业站稳脚跟。

继与美国就关键和新兴技术（iCET）达成协议以加强半导体供应链的双边合作后，印度上周与日本签署了类似的谅解备忘录。

另外，至少三个印度邦已经宣布了旨在确保该领域投资的单独政策。

卡内基印度公司研究员科纳克·班达里表示，虽然慷慨的补贴和强有力的政策推动为该行业的腾飞奠定了跳板，但时间至关重要，技术转让将是印度成为制

造业中心的关键。

他表示：“企业是否承诺引进这些技术将取决于多种因素的结合，例如商业环境、国内市场、出口潜力、基础设施和人才。”

就目前情况而言，这个谜题似乎只有部分已经解决。

### 印度优势

印度优势半导体为现代数字生活的各个方面提供动力——从微型智能手机到控制互联网的大型数据中心。

先进的半导体技术在汽车行业向气候友好型电动汽车的转型以及人工智能应用的开发中也发挥着关键作用。

印度占全球芯片需求的 5%。德勤 (Deloitte) 表示，在智能手机、消费类电器和自动驾驶汽车等新趋势的推动下，到 2026 年这一数字可能会翻一番。

国内市场显然正在蓬勃发展。但在芯片生产价值链的关键阶段——产品开发、设计、制造、ATP（组装、测试和封装）和支持——印度仅在设计功能方面拥有强大的影响力，而在涉及到芯片生产时，印度将不得不从头开始。制造业。

德勤合伙人 Kathir Thandavaryan 告诉 BBC：“印度拥有全球 20% 的芯片设计人才。有 5 万名印度人从事这项工作。”

大多数半导体制造商——包括英特尔、AMD 和高通——也在印度拥有最大的研发中心，利用当地的工程人才。

然而，根据德勤的说法，获得训练有素的人员可能成为公司的主要阻力，当投资开始流入时，估计需要 25 万人在整个价值链上工作。

因此，该领域加强产学合作至关重要。

值得赞扬的是，政府一直在努力实现这一目标，例如通过“芯片启动”计划培训 85,000 名工程师。

专家表示，许多其他因素——例如物流、基础设施和效率全球排名的提高，以及更稳定的电网（半导体制造的关键先决条件）——都增强了印度参与这场全球竞赛的准备。

地缘政治似乎也对印度有利，美国越来越关注寻找中国以外的替代地点，以外包其部分半导体供应链。

坦达瓦良表示，印度作为一个日益亲密的盟友，可以成为寻求外包支持职能

的美国公司的一个可行的“朋友支撑”目的地。

但其保护主义贸易政策，特别是其在 RCEP（区域全面经济伙伴关系）等多边贸易协定中的缺失，可能会付出高昂的代价。

班达里先生表示：“如果中国以外的半导体公司要实现多元化，那么如果将其零部件转移到越南，它们不太可能面临适用于其零部件的关税方案的重大变化。这是因为属于同一区域贸易安排的国家之间可能会更加统一。”

### 绊脚石

然而，新德里将自己定位为芯片制造商的全球选择所面临的巨大挑战是各行业制造商都非常熟悉的挑战——众所周知的困难的“营商”环境。

这个以软件实力闻名的国家实际上并不具备硬件能力。由于缺乏有利的生态系统，制造业占 GDP 的比重多年来一直停滞不前。

专家表示，印度需要进行“根本性且持久的改革”来改变这一现状，并使其半导体使命取得成功。

美国信息技术与创新基金会负责全球创新政策的副总裁斯蒂芬·埃泽尔对英国广播公司表示：“这需要解决海关/关税、税收和基础设施等投资障碍。”

“如果激励措施是吸引半导体 ATP 或晶圆厂的首要战略，印度将无法与中国、欧盟或美国等竞争对手进行长期竞争。”

这主要是因为印度的半导体激励政策只是世界上众多半导体激励政策之一。欧盟或美国等集团同时提供的补贴要大得多。

班达里先生表示，大多数公司也不会为了补贴而立即将其业务转移到其他地方，“因为它们拥有由供应商、合作伙伴、消费者和物流网络组成的现有生态系统——所有这些都使得它们很难将业务转移到其他司法管辖区”。

专家表示，印度的补贴也可以得到更好的引导。

目前，它在芯片制造价值链的各个末端提供这些服务。相反，该国可以发挥其优势。

例如，它可以投资工程师培训学校，或者加倍提高在半导体 ATP 和设计支持方面的竞争力，而不是在芯片的实际制造上，因为芯片的实际制造是资本密集型且酝酿期长的。

埃泽尔先生警告说，政府绝不能陷入专注于捏造事实的“闪亮物体综合症”。

然而，他补充说，在这一领域具有竞争力将标志着“国家的重大技术飞跃”，政府尝试在这一领域寻求更多投资是正确的。

班达里表示，随着国内电子产品产量突破 1000 亿美元大关，缺乏国内制造设施也会“对印度的进口成本产生严重影响”。

### 高风险的赌博

印度的半导体赌博显然关系重大。过去它曾有过几次错误的开始。但经过多年的拖延后，一项大体正确的专门政策只是朝着正确方向迈出的第一步。

班达里先生表示，这是“纠正先前失误的新机会”。“地缘政治明星们已经联合起来，为这个机会提供帮助。在一个供应链支离破碎的动荡世界中，印度发现自己正处于十字路口——它要么认真尝试培育硬件制造业，要么放过另一个机会。”（来源：半导体行业观察）